

Imagen de producto

El elemento básico de la carcasa modular CH20M ofrece una serie de ventajas que la convierten en una excelente opción para tus proyectos. Con recortes especiales para contactos de bus y FE, es especialmente flexible y adaptable.

Otro punto a favor es la opción de impresión láser en la carcasa, que te ofrece alta precisión y opciones de diseño individualizadas. También está disponible una amplia gama de colores para que puedas diseñar la carcasa completamente según tus deseos.

La carcasa CH20M también es adecuada para carriles de montaje estándar, lo que facilita la instalación y la integración en sistemas existentes.

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris grafito, Base, Rebaje en la zona del pie del retén para contacto BUS, Anchura: 67.5 mm
Código	1413780000
Tipo	CH20M67 B BUS GGY/BK 2019
GTIN (EAN)	4050118214901
Cantidad	4 Pieza

CH20M67 B BUS GGY/BK 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	108 mm	Profundidad (pulgadas)	4.252 inch
Altura	109.3 mm	Altura (pulgadas)	4.3031 inch
Anchura	67.5 mm	Anchura (pulgadas)	2.6575 inch
Peso neto	44.55 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40...120 °C
Humedad	5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66 GF 30
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	gris grafito	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 7024
Capacidad de sellado	No		

Propiedades del ensamblaje

Número de ranuras para conectores hembra del conjunto montado, máx.	18	Número de placas de circuitos impresos, 3 máx.
Número de niveles de conexión, máx.	3	Número de polos, máx.
Altura de componentes en PCB (aplicación de 1 PCB), máx.	61.1 mm	Altura de componentes en PCB (aplicación de 2 PCB), máx.
Altura de componentes en PCB (aplicación de 3 PCB), máx.	34.7 mm	Tipo de montaje de la placa de circuitos doble cara impresos

Controles mecánicos

De conformidad con la norma	DIN EN 61373:1999 (choque y vibración)	
Condiciones de control	Instalación de tres cajas en fila, 200 g de peso adicional por placa de circuitos impresos, Tres placas de circuitos impresos montadas	
Ejes probados	X, Y, Z	Todas las pruebas mecánicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Control de impacto	Consejos de prueba generales	
	Categoría de control	1

CH20M67 B BUS GGY/BK 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Control de vibración	Número de impactos por eje	3 en dirección positiva y negativa
	Duración de impacto	30 ms
	Aceleración horizontal	30.00 m/s ²
	Aceleración vertical	30.00 m/s ²
	Aceleración longitudinal	50.00 m/s ²
	Categoría de control	1B
	Duración del control	5 horas por eje
	Aceleración efectiva	7.9 m/s ²

Ensayos térmicos

Controles térmicos	Consejos de prueba generales	Todas las pruebas térmicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
	Condiciones de control	Instalación de siete cajas en fila - Sin separación
	Ejes de control	horizontal
	Temperatura ambiente	80 °C
	Disipación de energía, máx.	5.7 W
	Temperatura ambiente	60 °C
	Disipación de energía, máx.	8.1 W
	Temperatura ambiente	40 °C
	Disipación de energía, máx.	10.8 W
	Temperatura ambiente	20 °C
	Disipación de energía, máx.	13.6 W

Características de componente

Color de pie acoplable	negro	Escotadura en área de pie acoplable como preparación para	Contacto de bus, ¡Contacto no incluido!
Número de niveles de conexión, máx.	3		

Diseño - Requisitos IN

Tolerancia del contorno del circuito impreso	±0,1 mm	Grosor de la placa de circuito impreso	1.6 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.	±0,15 mm		

Opciones de individualización

Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí	Proceso de pedido específico del cliente	Consulte la directriz bajo descargas
Colores alternativos	Más bajo pedido	Posibilidades de procesamiento	Procesamiento láser

Indicación importante

Información de producto	El contorno de la placa de circuitos y las zonas restringidas, entre otros muchos datos de diseño de la placa de circuitos, pueden encontrarse en la categoría de tecnología de conexión, debajo de los conectores macho correspondientes, en las descargas.
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

CH20M67 B BUS GGY/BK 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto

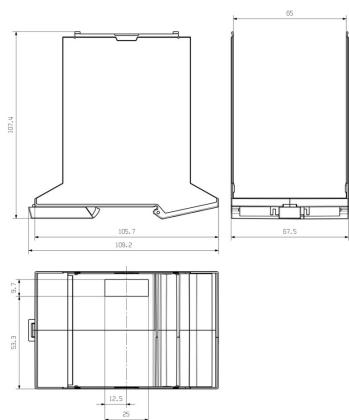


Ventaja del producto



Base incluyendo escotadura BUS

Dibujo acotado



Accesorios

Bloque de contacto de bus - Brida para soldar



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasa para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridales para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

Datos generales para pedido

Tipo	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Versión
Código	1155900000	Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para
GTIN (EAN)	4032248942381	CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR,
Cantidad	300 ST	Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Tipo	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Versión
Código	1155890000	Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para
GTIN (EAN)	4032248942527	CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR,
Cantidad	78 ST	Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro

Accesos

Bloque de contacto de bus - Brida para soldar intermedia



El bus de carril integrado para el sistema modular de carcasa para componentes electrónicos. Al alimentar, conectar o distribuir dentro de aplicaciones modulares, el bus de carril puede sustituir el tedioso proceso de cableado individual por una solución flexible y continua a nivel de sistema.

El sistema de bus está integrado de forma segura en el carril estándar de 35 mm. El bloque de contactos de bus SMD puede soldarse mediante reflow de forma que el montaje de componentes se realiza de forma totalmente automática. Las resistentes superficies de contacto bañadas en oro garantizan un contacto fiable y duradero para todos los anchos de carcasa.

- Escalabilidad ilimitada La solución de conexión integrada cubre todos los anchos de sistema: desde el módulo de 6 mm hasta la capota de gran capacidad de 67 mm.
- Fácil de mantener durante la instalación Sustituir un módulo es sencillo, incluso en grupos de módulos existentes, – sin afectar a los módulos adyacentes.
- Integración universal El bus de sistema continuo está integrado de forma segura en el carril de montaje estándar de 35 mm.
- Máxima disponibilidad Cinco contactos de doble arco totalmente galvanizados y parcialmente bañados en oro garantizan un contacto permanente con el bus de carril. Las bridales para soldar THR aseguran una conexión estable con la placa de circuito.

Datos generales para pedido

Tipo	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3....	Versión
Código	1155880000	Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para
GTIN (EAN)	4032248942305	CH20M12-67, Brida intermedia para soldadura, Conexión por
Cantidad	300 ST	soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, bañado en oro, negro
Tipo	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3....	Versión
Código	1155870000	Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para
GTIN (EAN)	4032248942510	CH20M12-67, Brida intermedia para soldadura, Conexión por
Cantidad	78 ST	soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, bañado en oro, negro